

2026 半导体与电子用高纯金属粉体制备与应用大会

当前，国内半导体与电子材料国产化进入攻坚阶段，先进制程晶圆制造、Chiplet 先进封装、CPO 光电共封、AI 算力芯片四大赛道同步扩能。超高纯金属粉体作为溅射靶材、微纳互连焊料、MLCC 内电极及高导热界面材料的核心基础原料，其纯度、氧含量、球形度与批次一致性直接决定芯片良率与器件长期可靠性，是产业链自主可控的核心卡点。

MLCC 超细镍粉、半导体级高纯钨粉、铜 / 银基电子粉体、超细锡焊粉、高纯钼粉、纳米烧结银六大核心品类需求同步爆发：AI 算力拉动高容镍粉年增速超 22%，80nm 以下高端规格仍高度依赖进口；先进制程推动高纯钨、钼粉量价齐升，6N 级以上超高纯产品国产化率不足 30%；高银价倒逼铜代银加速，但下游认证周期长达 18 个月，批量导入缓慢；高端封装互连材料普遍存在结构性供给缺口。

上游超高纯制备、全程低氧量产工艺仍存短板，高端制粉设备核心部件国产化率不足五成；中游靶材、浆料、MLCC 厂商普遍面临国产粉体认证周期长、批次性能波动大等痛点；下游终端亟需稳定可控的本土粉体供应链，但可靠性验证数据积累不足。上下游技术信息断层、供需匹配效率偏低，亟需专业平台打通全链路创新闭环。

为构筑产学研协同创新平台，加速国产高纯粉体批量导入头部产线，中国粉体网定于 2026 年 11 月 12 日在苏州举办 2026 半导体与电子用高纯金属粉体技术大会。大会聚焦超高纯制备工艺、产线国产化验证与供需精准对接，打造“主旨报告 + 闭门采配 + 成果展示”三位一体交流载体，汇聚高校院所、粉体企业、龙头用户研发与采购决策层，联合攻坚量产工艺卡点，共建自主可控的电子材料供应链生态。

时间：

2026 年 11 月 12 日

地点：

苏州

主办单位：

中国粉体网 中粉会展

会议主题：

- 1、5N/6N 级超高纯金属粉体制备：痕量杂质脱除与全程低氧量产工艺
 - 2、 高端球形粉量产路线对比、等离子雾化、气相法、液相法工艺及装备国产化进展
 - 3、超细/纳米镍粉湿化学制备技术及高容 MLCC 适配方案
 - 4、球形/片状纳米银粉量产及其导电浆料国产化替代
 - 5、低温铜/银烧结粉体开发、封装良率提升与电子浆料降银技术
 - 6、高纯钨粉制备与靶材国产化协同：从实验室到量产的工程化瓶颈
 - 7、贵金属废粉提纯再生与循环利用成套技术
 - 8、金属粉体表面改性与长期可靠性评测
 - 9、纳米金属粉体全维度表征：氧含量、粒径、振实密度与洁净度检测体系
 - 10、先进金属粉体制备、高精度分级、低氧环境控制及检测设备国产化进展
 - 11、先进 Chiplet 封装对金属粉体纯度与形貌的新技术标准
-

特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购, 工艺方案等需求进行现场采配活动, 相关信息将进行展板展示, 提高现场沟通交流效率!

征集内容包含但不限于以下几点:

- 1、半导体高纯粉体项目投融资、产学研成果转化需求
- 2、粉体纯度、变形、孔隙、氧含量等工艺痛点解决方案征集
- 3、高纯金属原料、雾化设备、检测仪器、洁净耗材采购需求

4、靶材、封装、MLCC、光模块企业国产粉体供应商寻源需求.....

会议费用：

2800 元/人

费用包含：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿

收款账户

户名	山东中粉网信息技术有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行
账号	37050182640100001790

大会赞助：

（赞助详细内容请联系会务组了解）

- 1、协办赞助（含展位、企业致辞，会议期间 360 度环屏广告，视频播放，企业报告等）
- 2、晚宴赞助（含展位、晚宴 360 环屏大屏展示、晚宴致辞、主持人口播广告等）
- 3、其它赞助（会议礼品、环屏广告、侧屏广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）
- 4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

会务组：

联系人：朱经理

手 机：19709836050（同微信）

邮 箱：zhuwenhu@cnpowder.com

